



三井金属

三井金属鉱業株式会社

東京都品川区大崎1-11-1

郵便番号 141-8584

2014年9月10日

各 位

薄型基板内蔵キャパシタ材料の生産能力を拡大

当社 三井金属（社長 仙田貞雄）はこのたび、薄型基板内蔵キャパシタ材料【商品名：ファラドフレックス(FaradFlex®)】の生産能力を拡大いたしましたのでお知らせいたします。

ファラドフレックス(FaradFlex®)（※1）は、各種の情報通信機器が更なる高速化・高容量化をする際に大きな課題となっている通信ノイズを低減するための材料として、高性能のルーター・サーバー機器やスーパーコンピュータ向けの高多層基板や、スマートフォンに内蔵されるMEMS マイクロフォン（※2）などに使用されております。

ファラドフレックス（FaradFlex®）の需要は、それら電子機器の生産拠点であるアジア市場を中心に急速に高まっており、今後も更なる需要増が見込まれます。

その需要急増に対応するため、当社では従来のも米国 Oak-Mitsui Technologies LLC での製造に加え、本年4月にマレーシア MITSUI COPPER FOIL (MALAYSIA) SDN.BHD.（以下、マレーシア工場）において一貫生産ラインを増強致しました。この度主要ユーザーからの認定が得られましたので、本年7月以降本格稼働に移行いたしました。

マレーシア工場では、これまでファラドフレックス(FaradFlex®)の前工程を担ってまいりましたが、今回の一貫生産ラインの導入により、主な需要先であるアジア市場へのリードタイムが大幅に短縮され、お客様の利便性向上に寄与できるものと考えております。

当社は、今後も成長を続けるファラドフレックス(FaradFlex®)の高い品質の維持と安定供給に向け、引続き注力してまいります。

以 上

【お問い合わせ先】

三井金属 経営企画部 IR・広報室 TEL 03-5437-8028 FAX 03-5437-8029

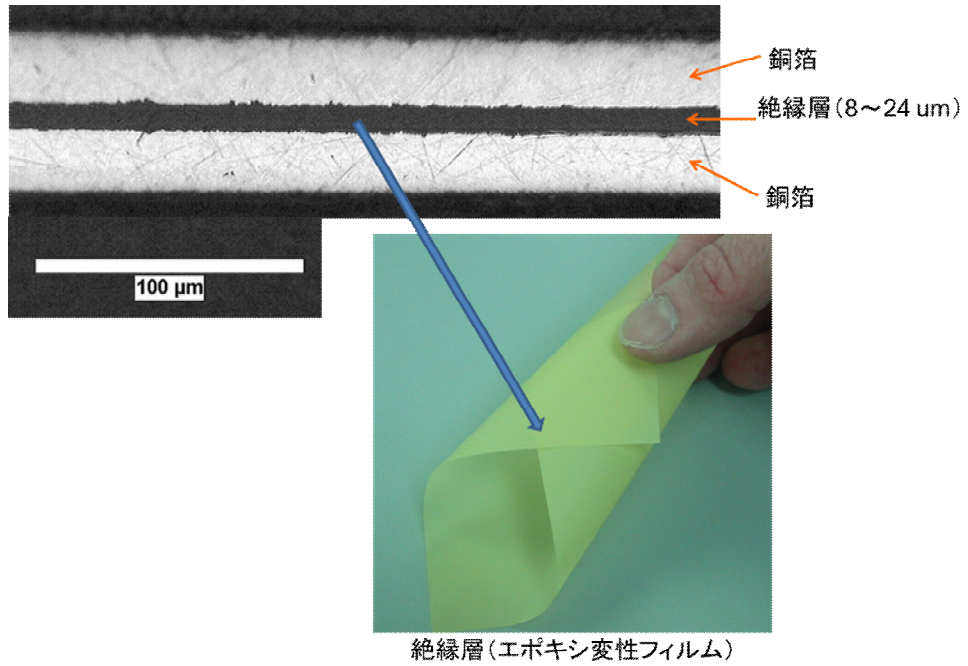
Eメール PR@mitsui-kinzoku.co.jp

【ご参考】

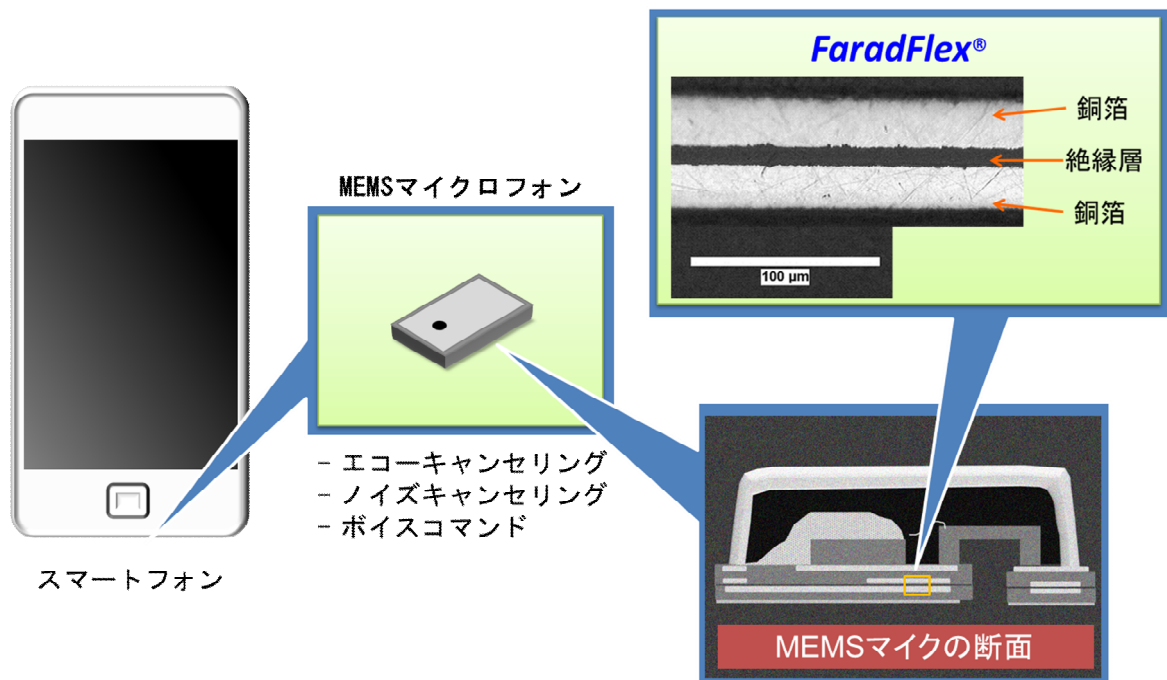
(※1) ファラドフレックス(FaradFlex®)の構造

ファラドフレックス(FaradFlex®)は、絶縁層であるフィルム状樹脂材料（エポキシ変性フィルム／厚さ8～24 μ m）の両面を銅箔（厚さ18～70 μ m）でサンドイッチ状にした構造の材料。

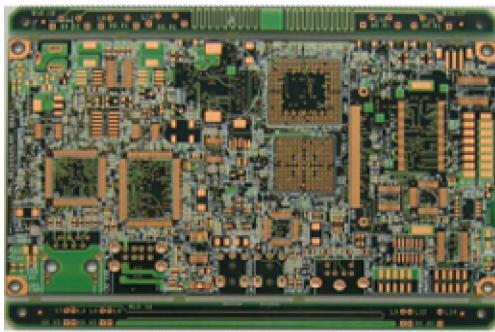
FaradFlex®の断面図



(※2) 基板内蔵キャパシタの使用例1

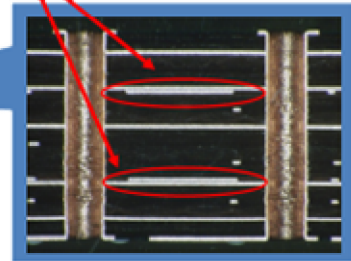


基板内蔵キャパシタの使用例 2



積層プリント配線板
(電子部品内蔵型基板)

基板内蔵キャパシタ



基板断面図

* 基板内蔵キャパシタは、積層されたプリント基板の内部に埋め込まれ、コンデンサとして機能します。

【関係会社概要】

【Oak-Mitsui Technologies LLC】

- (1) 所在地 : アメリカ合衆国ニューヨーク州
- (2) 設立 : 2003年1月
- (3) 資本金 : 1,000 US ドル (Oak-Mitsui Inc. 全額出資)
- (4) 社長 : 桑子富士夫
- (5) 従業員数 : 約 30 名
- (6) 事業内容 : 銅箔新規商品の研究開発および製造

【MITSUI COPPER FOIL (MALAYSIA) SDN.BHD.】

- (1) 所在地 : マレーシア国
- (2) 設立 : 1989年4月
- (3) 資本金 : 160,000 千マレーシアリングgit (当社 100%)
- (4) 社長 : 仲子啓
- (5) 従業員数 : 約 600 名
- (6) 事業内容 : プリント配線板用銅箔の製造

以 上